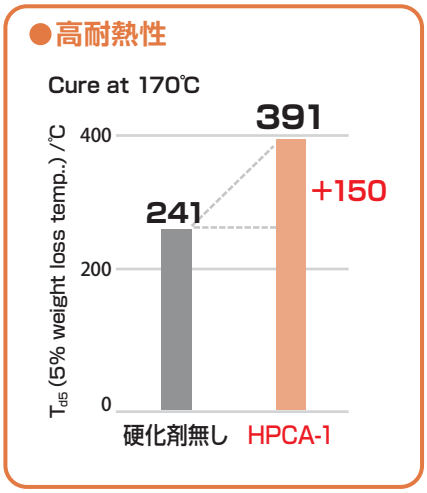
HPCA-1

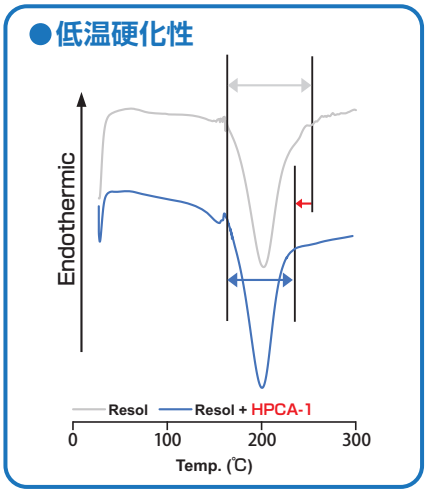
HPCA-1

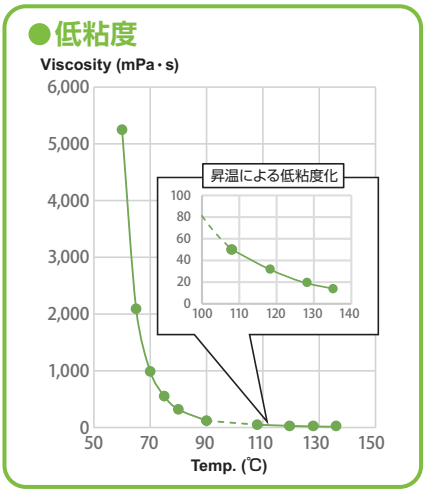
開発品

HPCA-1はレゾール型フェノール樹脂等の熱硬化性樹脂へ硬化剤として使用することで、低温での硬化、硬化物の耐熱性向上、また低粘度の性状が相溶性の向上に寄与します。

To thermosetting (e.g. resol) resins, Developed Product HPCA-1 will affect multiple functions, promoting curing at low temperatures, improving the heat resistance of cured composition and holding high compatibility by its low viscosity.







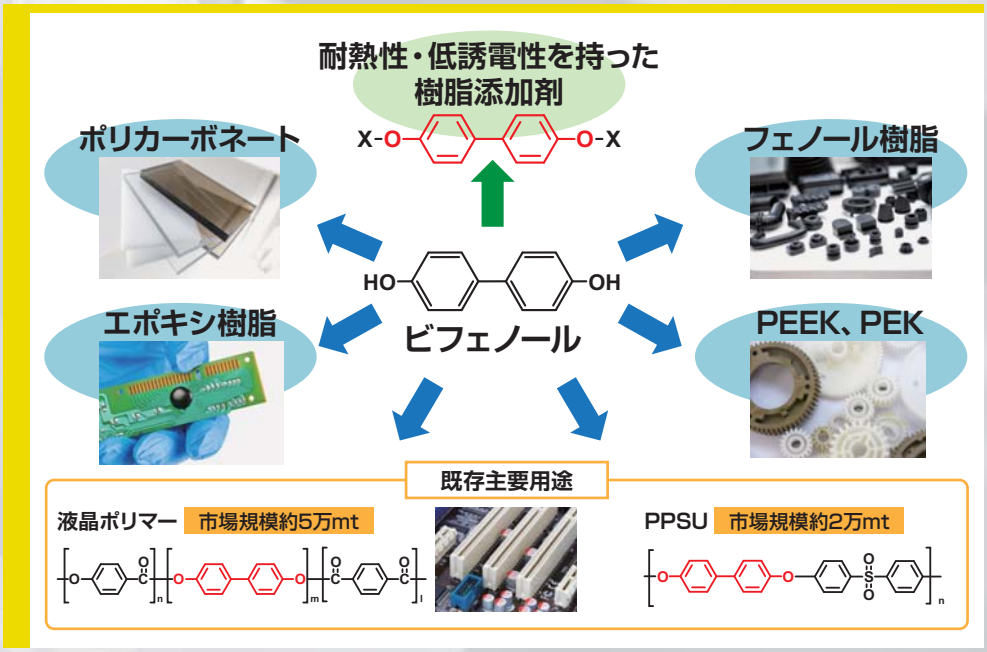
ビフェノール

Biphenol

耐熱性・低誘電性に寄与

ビフェノールは液晶ポリマー、サルホン樹脂等のスーパーエンジニアリングプラスチックの原料として使用されています。剛直なビフェニル骨格を樹脂に導入することで耐熱性や低誘電性に寄与する事例があり、次世代通信向け高周波材料への使用が期待されます。

Biphenol is used for super engineering plastics such as liquid crystalline polymers(LCP), polysulfones(PPSU). Introducing a rigid biphenyl skeleton into resins may contributes to heat resistance and low dielectric properties. Biphenol is expected to be used in high-frequency materials for next-generation communication.



HC2310